

大電流対応厚銅基板

Heavy Copper PWB

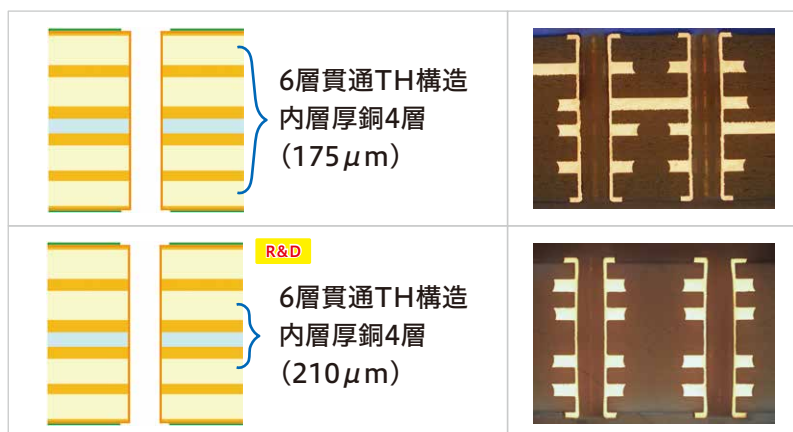
特長 Features

- ✓ 大電流ユニットに対応
Correspondence to Large Current unit
- ✓ 内層銅厚: 175 μ m、210 μ m (開発中)
Copper Thickness: 175 μ m~210 μ m (R&D)

用途 Application

ジャンクションボックス / 電源モジュール / 電源充電器 / インバーター / コンバーター / トランス / UPS など

基板構造 PWB Structure

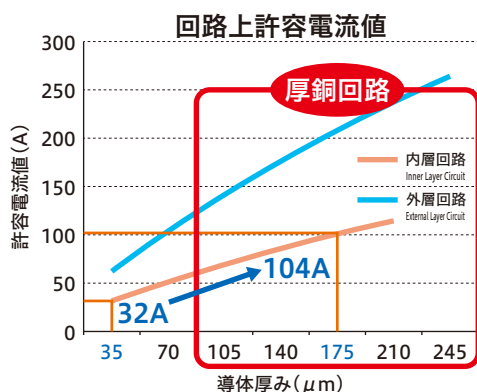


基板仕様 PWB specification

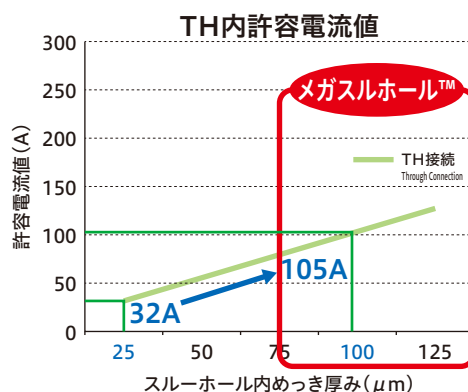
内層導体厚 Inner Layer Conductor Thickness	175 μ m	210 μ m R&D
層構成 Layer Construction	4層貫通 6層貫通	4層貫通 6層貫通
板厚 Board Thickness	~3.0mm (層構成により変動)	~3.0mm (層構成により変動)
最小導体厚 Min Conductor Width	400 μ m	450 μ m
最小導体間隔 Min Conductor Spacing	400 μ m	450 μ m

許容電流値 Current-Carrying Capacity

一般的な導体厚(35 μ m)の許容電流値は32Aとなりますが、導体厚を175 μ mにすることで許容電流値を100Aまで向上させる事が可能となります。更に弊社新技術『メガスルホール™』と厚銅基板を組み合わせることで立体的な回路配線においても大電流化が可能となります。



上昇温度 ΔT Temperature Rise	10°C
配線幅 Conductor Width	400mm



上昇温度 ΔT Temperature Rise	10°C
仕上がり穴径 Finished Hole Diameter	ϕ 0.40mm
穴数 The Number of Holes	52穴



※基板単体における単独配線を想定したシミュレーション結果であり、お客様での製品時点での結果ではありません。